

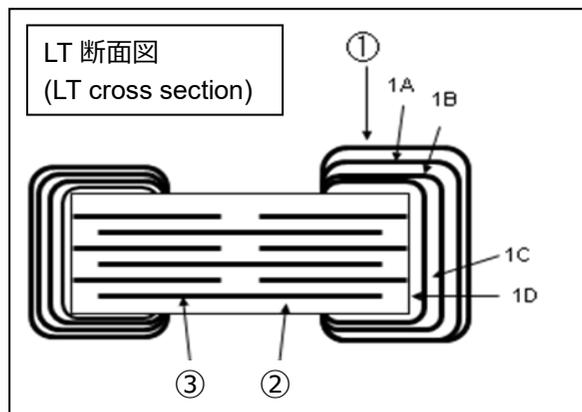
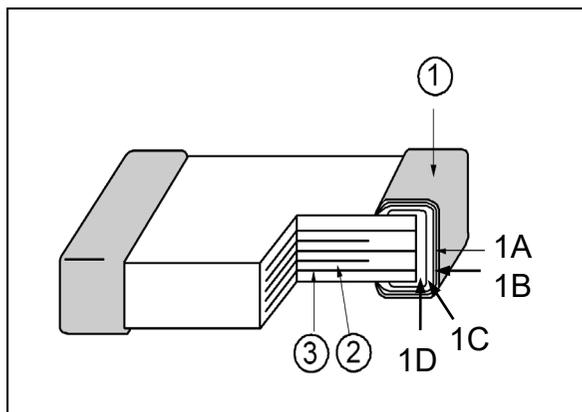
チップ積層セラミックコンデンサ構造図および材料表

Structure and Material of Chip Multilayer Ceramic Capacitor

<MLSC+樹脂電極GCEシリーズ>

<Soft termination MLSC Serial GCE Series>

1.内部構造/Structure



2.材料名/Material

| No. | 名称/Name | 材料/Material |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| ① | 外部電極 Termination | |
| | 1A めっき層 Plated layer | すず Tin |
| | 1B めっき層 Plated layer | ニッケル Nickel |
| | 1C 下地電極 Electrode | 導電性樹脂 Conductive Resin |
| 1D 下地電極 Electrode | 銅 Copper | |
| ② | 誘電体素子 Dielectric layer | チタン酸バリウム系 Barium titanate-based |
| ③ | 内部電極 Inner electrode | ニッケル Nickel |

J(E)MCZ0-1R0567C

<ご参考> 当社ウェブサイトにて、各シリーズの最新の構造図を入手いただくことが可能です。 → [構造図/材料表](#)

<Reference> The latest structure diagrams of each series are available on our website. → [Structure diagram. Materials chart](#)